

C-791铜导体浆料

概述:

C-791 是一款环保型铜导体浆料, 用于特种电子元器件的布线与引出端。产品成膜后附着力好, 导电性好, 可焊性好, 具有良好的金丝和铝丝键合性能。

主要技术指标:

项 目	测试方法	技术指标
色 态	目测	均匀浆状
粘 度 (Pa·s)	BROOKFIELD SC4-14 10RPM , 25°C	120-200
方 阻 (mΩ/□)	印刷图形0.6mm×60mm	≤3
初试附着力 (N)	2mm×2mm 剥离	≥20
老化附着力 (N)	+ 150°C, 24Hr	≥15

注:主要技术参数基于推荐工艺条件下实验室测试所得

推荐工艺与使用说明:

印刷丝网: 200 ~ 320目不锈钢丝网、乳胶厚度 12 ~ 20μm.

印刷基板: 96%氧化铝,表面粗糙度2-3μm

干燥条件: 室温流平5-10 min, 100-120°C, 烘干10 min.

更高温或更长时间干燥需氮气保护下进行.

烧结条件: 氮气氛烧结炉,气氛氧含量小于10ppm,750-850°C, 峰值9-11 min,烧结条件可结合实际使用条件和需求适当调整。

烧结膜厚: 15-20μm

表面处理: 烧结膜表面进行打磨处理或专用铜材表面清洗剂处理有利于焊接及键合.

粘度调整: 最好使用专用稀释剂稀释, 用量不超过1%。

储存条件: 贮藏于5-10°C冷藏柜中, 保质期6个月。

使用建议: 浆料未开封条件下充分回温, 印刷前用刮刀搅拌均匀;

产品使用场地洁净、通风良好.